

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-028

债券代码：118063

债券简称：金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于因实施权益分派调整“金 05 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：89.28 元/股
- 调整后转股价格：88.60 元/股
- 转股价格调整实施日期：2026 年 5 月 8 日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2025）2719 号），同意海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 16,715,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 167,150.00 万元，并于 2026 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金 05 转债”，债券代码“118063”。

2026 年 4 月 10 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 元（含税）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定，在“金 05 转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股

本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将进行转股价格的调整。

因此，本次可转债转股价格的调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》规定，在“金 05 转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司将于 2026 年 5 月 7 日（本次现金分红的股权登记日）实施 2025 年年度权益分派方案，由于公司本次分红为差异化分红，上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，虚拟分派的现金红利为 0.679 元（含税），具体情况详见同日披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。

转股价格调整公式：派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

其中， P_0 为调整前转股价 89.28 元/股， D 为每股派送现金股利。 $P_1 = 89.28$ 元/股 - 0.679 元/股 \approx 88.60 元/股。

“金 05 转债”的转股价格将由 89.28 元/股调整为 88.60 元/股，调整后的转股价格将自 2026 年 5 月 8 日起生效。

三、其它

投资者如需了解“金 05 转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

公司联系方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0898-66811301-302

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年4月28日